



**千住金属  
業**

千住金属工業は14～16日に、東京ビッグサイトで開催された「インター  
ネブコンジャパン」の併設展「半導体パッケージ技術展」に出展した。

外観を白色と木目で統一

## 「接合の未来」を訴求

高度な技術力  
豊富な製品群  
3ソリューションで提案

けられ、連日  
1ショットで紹介した。

内外ともに注目を集めた  
千住金属工業のブース

多くの顧客が  
訪問、真剣な  
商談が行われ  
ていた。

今回、同社  
は「接合の未  
来を拓くSM  
ICテクノロ  
ジー」をテーマ  
に、高度な  
グレーリングを防ぐする  
ついた。

やに入り込んだ「MAC  
ROS」と、ソルダーペ  
ースト「CLR」などを  
紹介した。

高度な素材開発力で、  
スニ熱硬化樹脂を含有させ、接合を補強した低融  
点Sn-Bi系ソルダーペースト「L201JP

P」、超微細はんだ粉末

と酸化を抑制したフラッ  
クスでO2O1型部品の  
実装を可能にした「RG  
S800」などが紹介さ  
れた。

ブースの外では、3日  
間を通じて「車載用途に  
好な作業環境と美しい外  
形、今回の出展テーマに  
合わせて63回ものプレゼン  
テーションも行われた。